## AMPMODU | AMPMODU Headers

Interne TE-Nummer 5-102690-6

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 80 Position, 2.54 mm

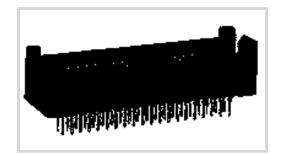
[.1 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Through Hole - Press-Fit,

AMPMODU Headers

Auf TE.com ansehen>



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

Montageausrichtung für Leiterplatte: Vertikal
Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anzahl von Positionen: 80

Zeilenanzahl: 2

## Eigenschaften

#### Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Vollständig ummantelt
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

## Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Nein
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	80
Zeilenanzahl	2
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

#### Elektrische Kennwerte

Anschlusswiderstand	12 mΩ
Spannungsfestigkeit (max.)	750 VACrms
Arbeitsspannung	250 VAC

## Sonstige Eigenschaften

## Kontaktmerkmale

Länge des Steckbereichs des Kontakts	5.08 mm[.2 in]
--------------------------------------	----------------



Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.64 mm[.025 in]
	100 – 200 μin
Kontaktform	Quadratisch
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn-Blei
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.762 μm[30 μin]
Kontakttyp	Stift
Kontaktnennstrom (max.)	2 A
Klemmenmerkmale	
Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen	.64 mm[.025 in]
Anschlussstift- und Restlänge	6.35 mm[.25 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit
Montage und Anschlusstechnik	
Gegensteckarretierung	Ohne
Art der Leiterplattenmontage	Aktions-/Kompatibles Endstück
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Führungsstifte
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage
Gehäusemerkmale	
Raster	2.54 mm[.1 in]
Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast
Abmessungen	
Steckverbinderhöhe	13.97 mm[.55 in]
Reihenabstand	2.54 mm[.1 in]
Stapelhöhe	11.43 mm[.45 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	2.36 mm[.093 in]
Verwendungsbedingungen	



#### Betrieb/Anwendung

Lötververfahrenfunktion	Plattenabstand
Stromkreis Anwendung	Signal
Industriestandards	
Zugelassene Standards	CSA LE7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
Verpackungsmerkmale	
Verpackungsmenge	16
Verpackungs-Typ	Rohr

## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

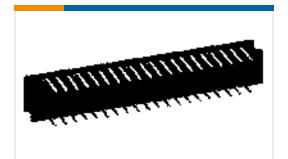
EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	BFR/CFR/PVC frei, allerdings Br/Cl >900 ppm aus anderen Quellen
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

# Kompatible Teile





TE Teilenr.: 6-532956-2 80 MODII 2PC CE RCPT ASSY, RoHS



TE Teilenr.: 5-534204-8 80 MODU 2-PC CE RECP ASSY, RoHS

# Auch serienmäßig | AMPMODU Headers



Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(66)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(5)



Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten(2)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (6117)



Montage von Leiterplatten-Steckverbindern(1)

## Kunden kauften auch diese Produkte







TE Teilenr.:4-1734260-0 WTB 1.25 PTH 30U" GLD 10 POS



TE Teilenr.:3-1761712-3 IDC LOW PRO HDR 40P RA LG LAT



TE Teilenr.:5-103801-5 10 MODII HDR DRRA B/A .100CL





## Dokumente

#### **CAD-Dateien**

Kundenmodell

ENG\_CVM\_5-102690-6\_L2.3d\_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG\_CVM\_5-102690-6\_L2.3d\_stp.zip

Englisch

3D PDF

Englisch

Kundenmodell

ENG\_CVM\_5-102690-6\_L2.2d\_dxf.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu

## Datenblätter/ Katalogseiten

AMPMODU\_INTERCONNECTION\_SYSTEM\_SECTION5\_CONT

Englisch

## Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

AMPMODU Mod II 2-Piece Double Row Header Assemblies

Englisch